

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RZ*-A007A/J	Rev.	第1版
題名	RZ/A1H グループ、RZ/A1M グループ 324 ピン BGA パッケージ品のパッケージインタポータ変更のご案内		情報分類	技術情報	
適用製品	下記参照	対象ロット等	関連資料	下記参照	
		全ロット			

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。

RZ/A1H グループ、RZ/A1M グループにおきましては、324 ピン BGA パッケージ品の耐熱性向上の為、パッケージインタポータの変更を行うことになりましたので、ご案内させていただきます。

敬具

記

■ 適用製品および関連資料

適用製品		関連資料	Rev.	管理番号
シリーズ	グループ			
RZ/A シリーズ	RZ/A1H RZ/A1M	RZ/A1H グループ、RZ/A1M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編	Rev 2.00	R01UH0403JJ0200

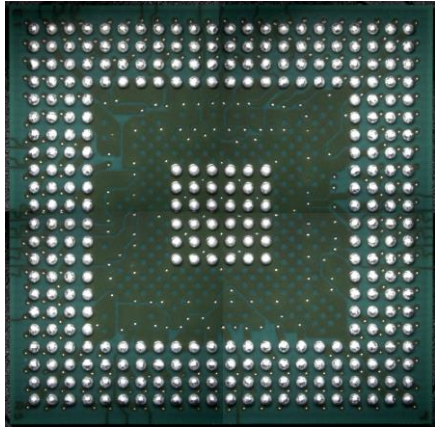
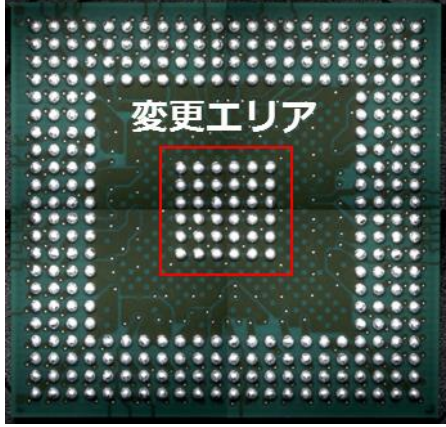
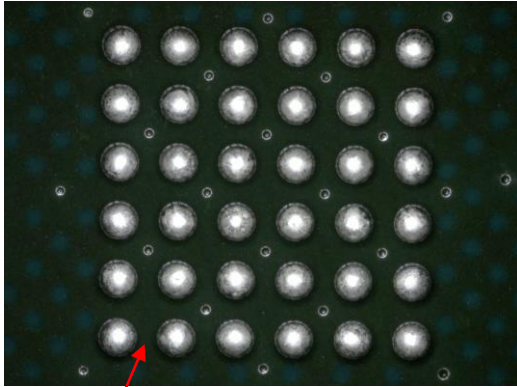
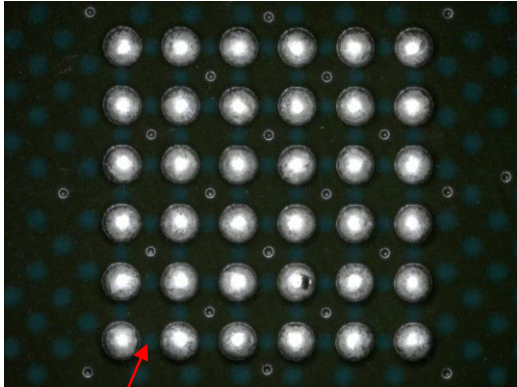
【1】変更による影響

324 ピン BGA パッケージ品のパッケージインタポータ変更による、電気的特性、信頼性への影響はございません。また、ピン配置、ハンダボール座標の変更もございません。

ただし、【2】に記載のように目で見てわかる外観上の差異がございますので、外観検査を実施する際はご注意ください。

【2】変更内容詳細

4層基板のうち、変更エリア(下図)の4層目(一番ボール側)に対してパターンを微修正を行っております。

	変更前	変更後
全体写真 (ボール面側)		
変更エリア 詳細	 変更エリアの基板は一面濃い緑色で、ボール間には変更エリア外に見える薄い緑色の丸は見えない	 変更エリアの基板のボール間には、変更エリア外と同じような薄い緑色の丸が見える

以上